



师资队伍

TEACHERS TROOPS

黄智恒的个人简介

暂无照片

<u>姓名</u>	黄智恒
<u>性别</u>	男
<u>职称</u>	副教授
<u>学历</u>	博士
<u>毕业学校</u>	英国拉夫堡大学
<u>联系电话</u>	020-84110530
<u>电子邮件</u>	hzh29 "at" mail.sysu.edu.cn
<u>个人主页</u>	
<u>所在学科</u> <u>主要研究方向</u>	电子封装及微连接; 材料热力学及动力学; 材料多场物理耦合模拟; 材料微结构模拟;
<u>教学科研情况</u>	<p>科研经历:</p> <p>2007年8月至2008年6月, Project Scientist, 马克思普朗克协会钢铁研究所 (杜塞尔多夫, 德国)</p> <p>2006年1月至2008年6月, Post Doctoral Research Associate, 拉夫堡大学 (拉夫堡, 莱斯特郡, 英国)</p> <p>2007年1月至2月, Academic Visitor, 浦项工科大学(浦项, 韩国)</p> <p>2002年10月至2005年12月, PhD Research Student, 拉夫堡大学 (拉夫堡, 莱斯特郡, 英国)</p> <p>2004年10月至2005年1月, Visiting Researcher, 弗朗霍夫可靠性和微系统集成研究所 (Fraunhofer IZM, 柏林, 德国)</p> <p>教学:</p> <p>《计算机在材料科学中的应用》, 本科, 2008-2009学年第2学期</p> <p>《电子材料与器件》, 本科, 2008-2009学年第2学期</p> <p>《科技英语》, 本科, 2009-2010学年第1学期</p> <p>本科毕业论文:</p> <p>徐洪远, 电介质击穿多物理现象耦合模拟, 2009年5月, 获学院优秀论文</p> <p>陈水旺, 肿瘤血管生成数值模拟, 2009年5月</p>
<u>承担课题</u>	<p>科研:</p> <p>主持教育部博士点新教师基金, 2010年-2012年</p> <p>主持广东省自然科学基金博士启动项目, 2009年-2011年</p> <p>主持中山大学“百人计划”科研启动项目, 2008年-2010年</p> <p>教学:</p> <p>主持2009年中山大学校级双语教学课程建设项目《计算机在材料科学中的应用》</p>

代表性论文:

1. Z. Huang, P.P. Conway, R.C. Thomson, A.T. Dinsdale, J.A.J. Robinson. A computational interface for thermodynamic calculations software MTDATA. CALPHAD-COMPUTER COUPLING OF PHASE DIAGRAMS AND THERMOCHEMISTRY 32(1), 129-134, 2008.

2. Z. Huang, P.P. Conway PP. A comparative study of numerical methods and computational tools for phase field equations of solidification. In: 2007 TMS Annual Meeting and Exhibition. Advances in Computational Materials Science and Engineering Methods, pp 1-9.

发表论文

3. Z. Huang, P.P. Conway, E. Jung, R.C. Thomson, C. Liu, T. Loeher, M. Minkus. Reliability issues in Pb-free solder joint miniaturization. JOURNAL OF ELECTRONIC MATERIALS 35(9), 1761-1772, 2006.

4. Z. Huang, P.P. Conway, C. Liu, R.C. Thomson. Effect of solder bump geometry on the microstructure of Sn-3.5 wt% Ag on electroless nickel immersion gold during solder dipping. JOURNAL OF MATERIALS RESEARCH 20(3), 649-658, 2005.

5. Z. Huang, P.P. Conway, C. Liu, R.C. Thomson. The effect of microstructural and geometrical features on the reliability of ultrafine flip chip micro solder joints. JOURNAL OF ELECTRONIC MATERIALS 33(10), 1227-1235, 2004.

获奖情况

1. Editor's Choice, paper in 2006 September issue of Journal of Electronic Materials, in TMS e-News, Vol. 07, Issue 09, 26 September 2006

2. Cookson Electronics Best Paper Award, 5th Int. Conf. on Electronics Materials and Packaging (EMAP), IEEE, Nov. 2003

3. Best Paper Award, 28th Int. Electronics Manufacturing Technology Symposium (IEMT 2003), IEEE, July 2003